



**Okamoto**

**株式会社岡本工作機械製作所**  
(証券コード：6125)

**2024年3月期第2四半期  
決算説明会資料**

**2023年11月14日**

## アジェンダ

1. 2024年3月期第2四半期 決算概況
2. 2024年3月期 通期業績予想
3. 中長期戦略「ビジョン2030」について

Appendix

# 1. 2024年3月期第2四半期 決算概況

# 決算サマリ

## 業績

- ✓ 売上高246億73百万円、営業利益29億8百万円
- ✓ 引き続き業績は好調に推移
- ✓ 国内では幅広い業種で大型平面研削盤を販売

## 受注実績

- ✓ 半導体関連装置は景気の先行きへの不安感から設備投資計画の見直しや先送りの影響あり
- ✓ 工作機械は大型平面研削盤の受注は落ち着くも、モータコア金型加工などの用途でEV車関連向け注文は継続
- ✓ 精密歯車はロボット向け歯車が低調

# 市場概況

## ■ 国内市場

- 工作機械は幅広い業種で大型平面研削盤を販売
- モーターコア金型加工などの用途でEV車向け大型平面研削盤の注文を受注
- 半導体も次世代パワー半導体や高周波通信デバイスなどEV車車載用途で需要堅調

## ■ 海外市場

- 北米市場は金利引上げの影響もあり中小企業中心に投資意欲低下
- 欧州はドイツの景気低迷やイタリアでの補助金政策終了の影響もあり受注は減少も、販売については汎用平面研削盤好調で売上は増加
- アジア市場は中国では精密歯車の需要は低迷も、EV車関連向け設備投資は活発でロータリー平面研削盤や小型成形研削盤の受注・売上が増加。東南アジアでは自動車関連の回復が遅れ、汎用平面研削盤の需要は伸びず。半導体関連では東アジアでパワー半導体向けポリッシャーなどの受注を獲得

## 業績ハイライト

(単位：百万円)

	2022年9月	2023年9月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	22,382	24,673	+10.2%
売上総利益	7,078	7,527	+6.3%
販売費及び一般管理費	4,415	4,619	+4.6%
営業利益	2,662	2,908	+9.2%
経常利益	2,701	2,944	+9.0%
当期純利益	1,878	1,860	▲0.1%

※小数点第2位を四捨五入

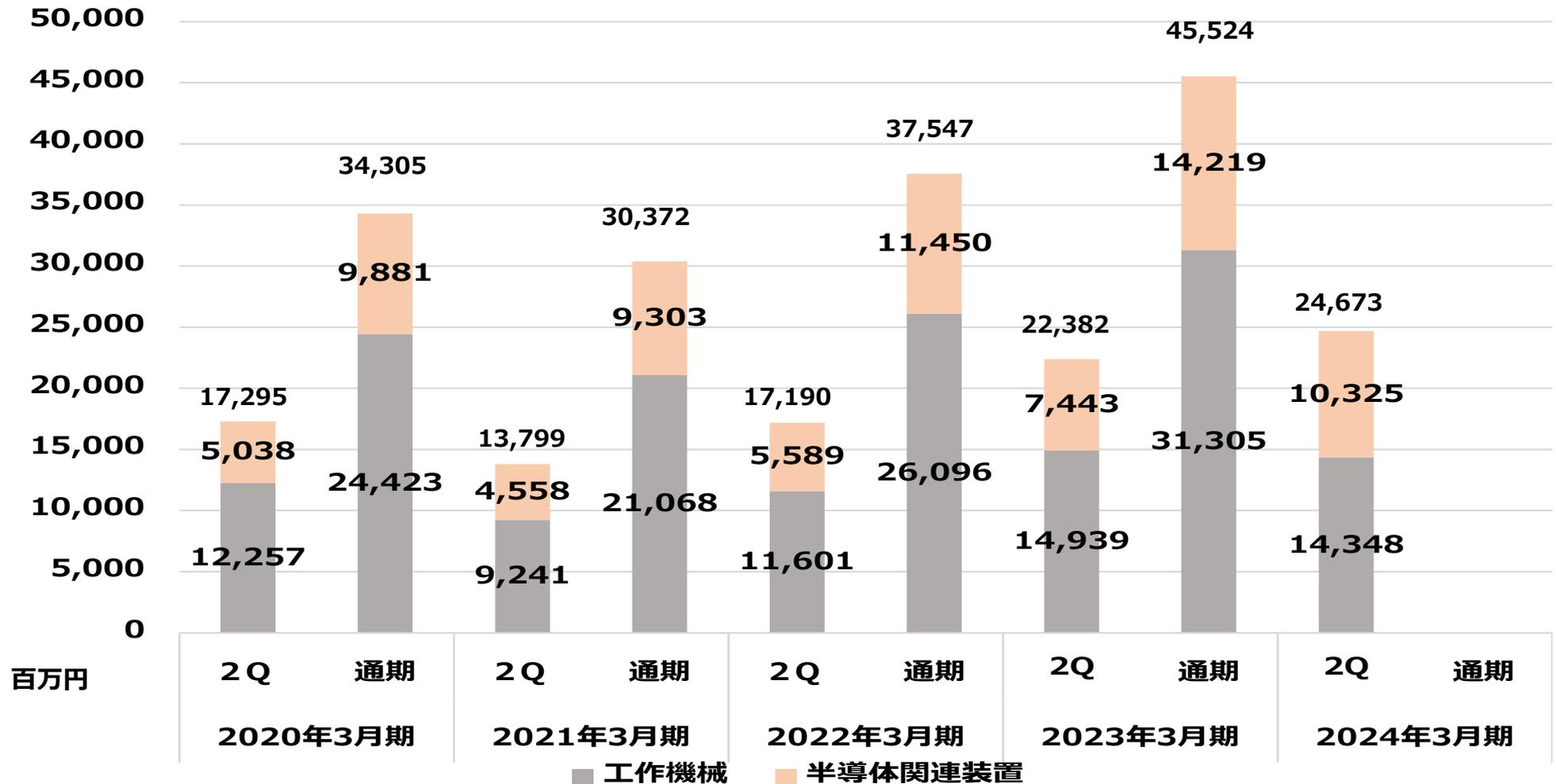
	2023年3月	2024年3月 (予定)
	金額	金額
設備投資額	3,921	3,891
減価償却費	1,521	1,713
研究開発費	165	238
為替レート	2023年3月期	2024年3月期 (計画)
米ドル	136.00	130.00
シンガポールドル	99.05	98.00
ユーロ	141.62	139.00
タイバーツ	3.84	3.80
人民元	19.71	19.20

※期中の平均レートで記載しております。

- 売上高は246億73百万円と前期223億82百万円に対し10.2%の増加、営業利益も前期26億62百万円に対し29億8百万円と9.2%の増加

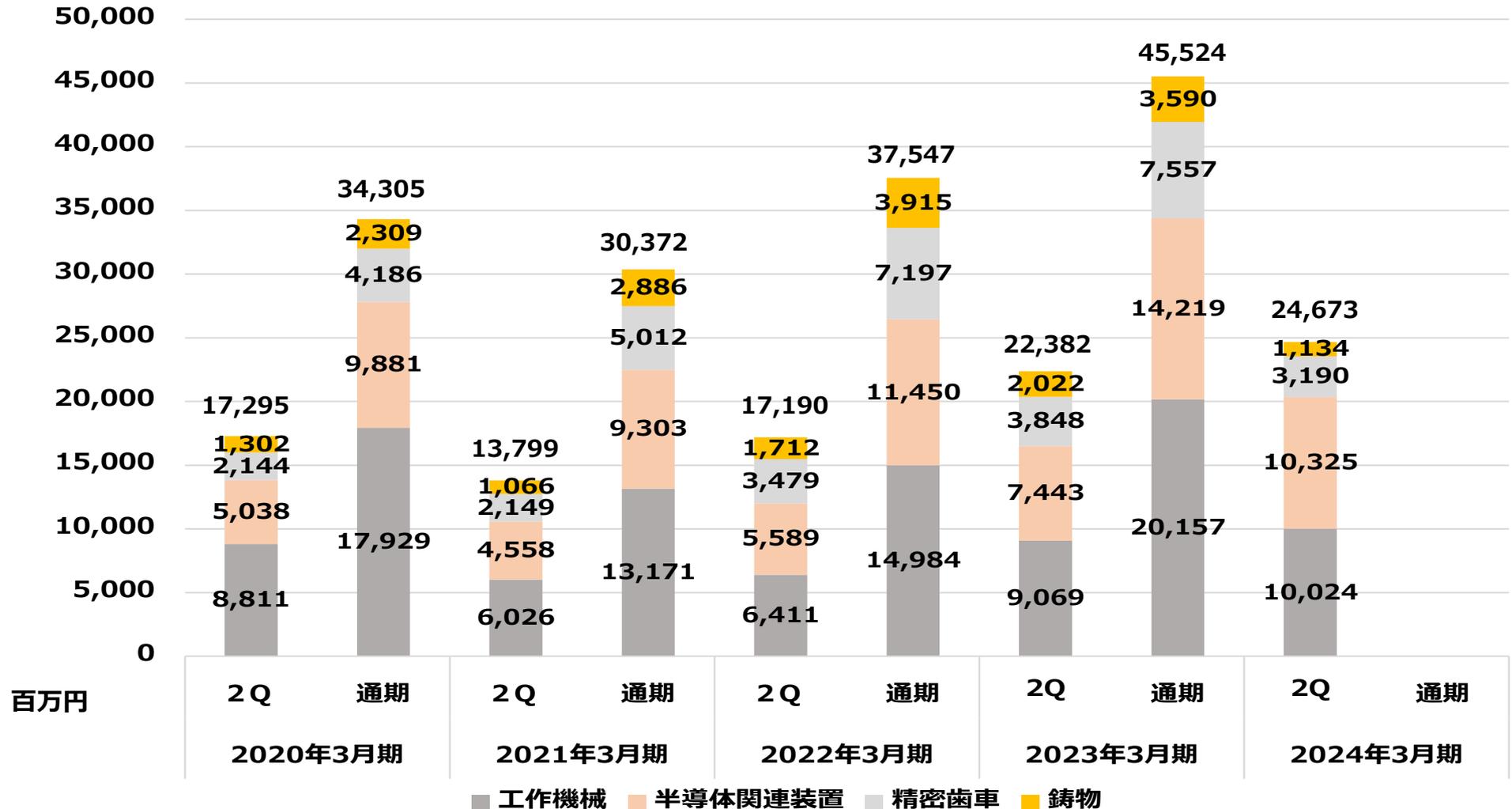
## セグメント別売上高推移①

引き続き業績は堅調に推移



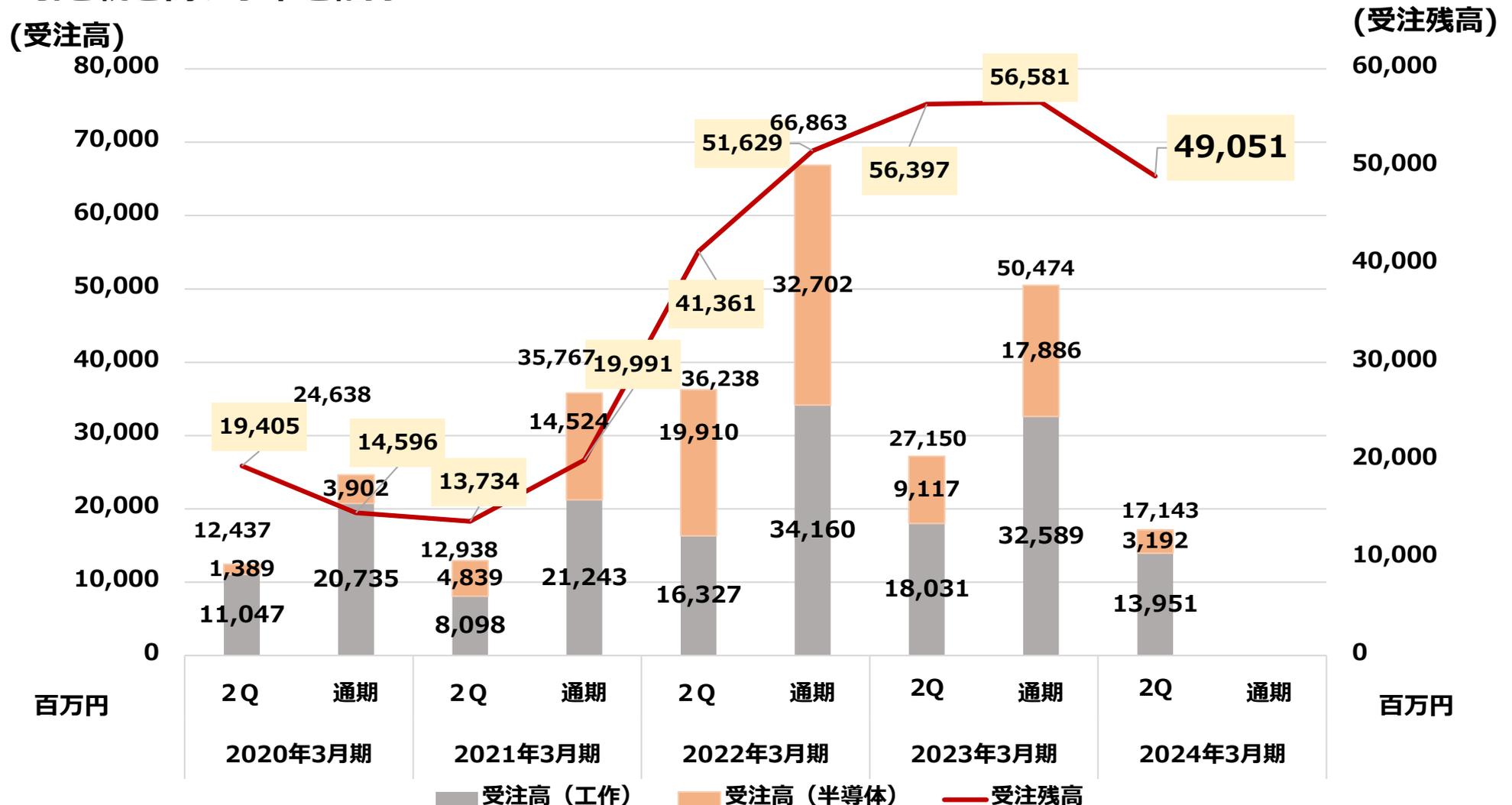
## セグメント別売上高推移②

工作機械は需要堅調、半導体関連装置も引き続き堅調も、精密歯車、鋳物は前年同期比マイナスに  
歯車は原材料価格値上がりの価格転嫁に注力も市況悪化の影響を受ける



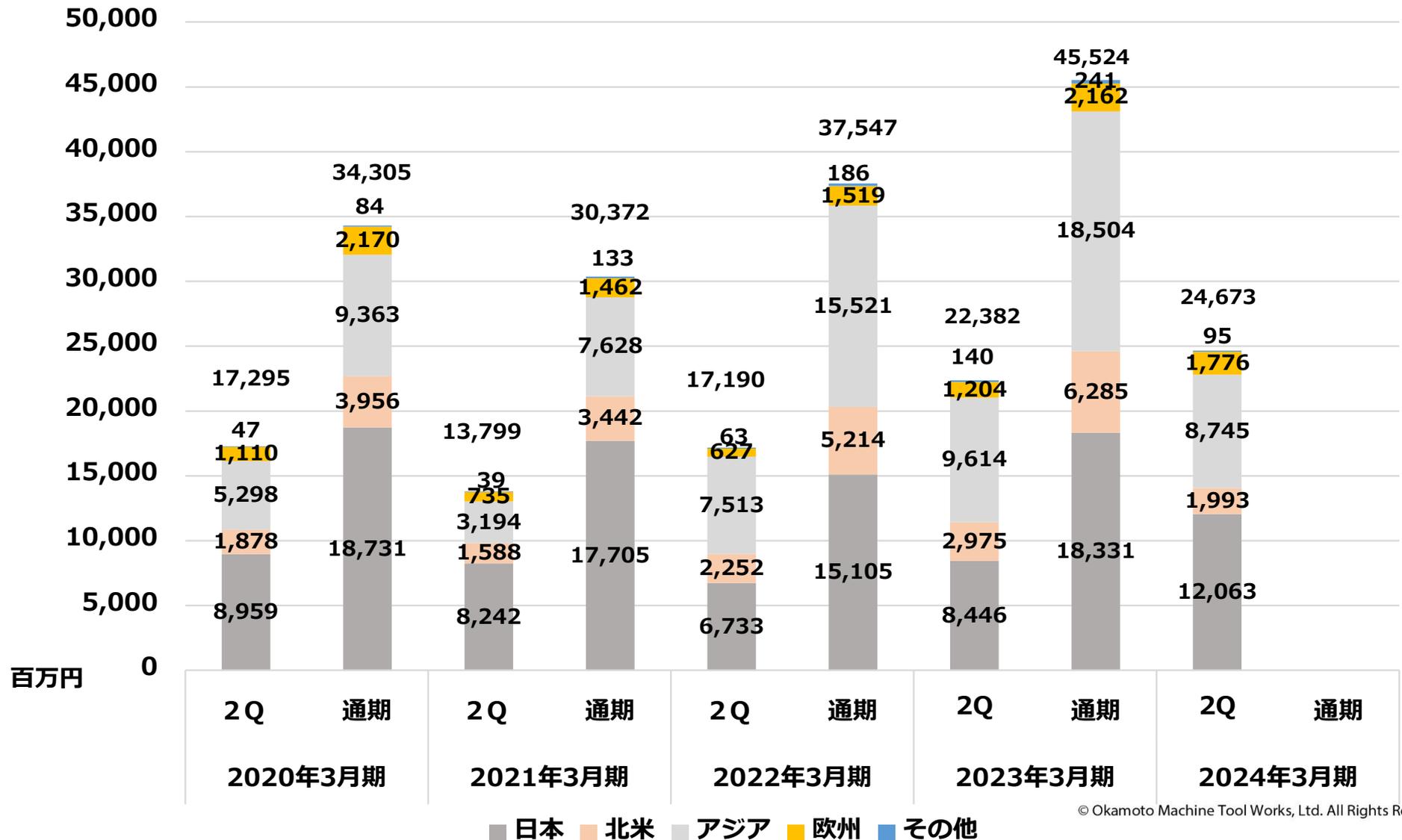
# 受注・受注残高

半導体関連装置はメモリの在庫調整などの影響もあり減速も、受注残高は490億51百万円と引き続き高い水準を維持



# エリア別売上高推移

北米は金利上昇の影響から前年を下回るも、国内（日本）は幅広い業種で大型平面研削盤の販売好調



## 比較貸借対照表

(単位：百万円)

	2023年3月		2023年9月	
	金額	金額	金額	対前期末比
流動資産	40,245	39,414	▲831	
現金及び預金	8,651	7,907	▲744	
受取手形及び売掛金	8,853	11,326	+2,473	
棚卸資産その他	22,741	20,181	▲2,560	
有形・無形固定資産	13,012	14,464	+1,452	
投資等	1,840	1,951	+111	
資産合計	55,098	55,831	+733	

(単位：百万円)

	2023年3月		2023年9月	
	金額	金額	金額	対前期末比
負債合計	30,238	28,614	▲1,624	
流動負債	28,237	24,354	▲3,883	
固定負債	2,001	4,259	+2,258	
純資産合計	24,860	27,216	+2,356	
負債資本合計	55,098	55,831	+733	

## 比較キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2023年3月	2023年9月	
	金額	金額	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,684	▲1,609	▲4,293
税引前当期純利益	5,537	2,930	▲2,607
減価償却費	1,521	859	▲662
売上債権の増減 (▲は増加)	▲549	▲2,288	▲1,739
棚卸資産の増減 (▲は増加)	▲3,722	▲60	+3,662
仕入債務の増減 (▲は減少)	542	628	+86
その他	▲645	▲3,678	▲3,033
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲3,079	▲2,250	+829
財務活動によるキャッシュ・フロー	406	▲228	▲634
換算差額	347	327	▲20
現金・現金同等物残高	12,375	8,614	▲3,761

# トピックス 九州半導体関連拠点展開①

2023年4月 熊本県の機械装置メーカー 株式会社プレシードに10%資本参加を実施  
 2023年10月 佐賀県伊万里市に「九州テクニカルサポートセンター」を開設



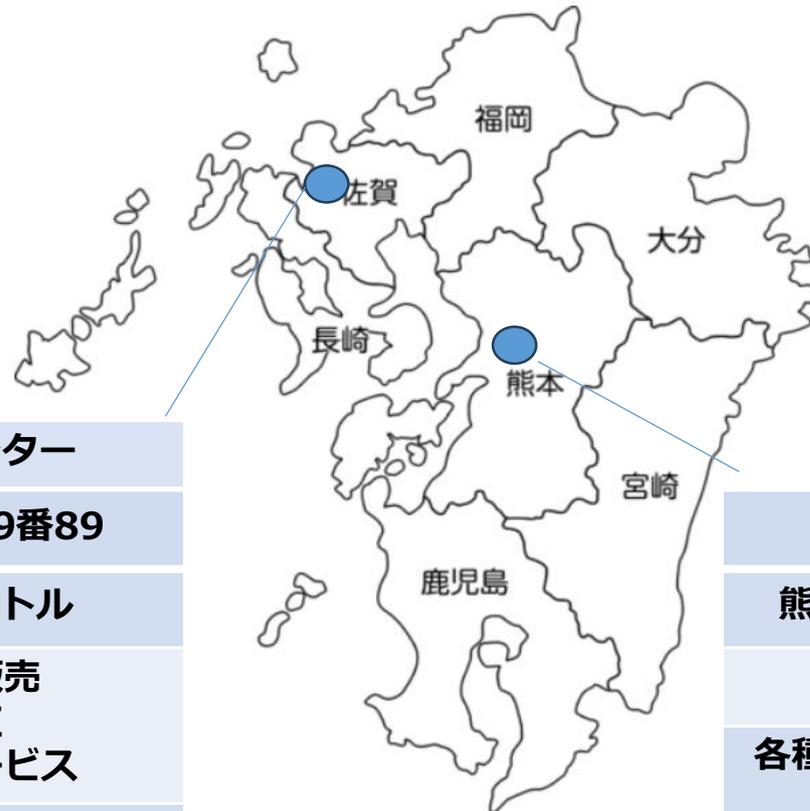
九州テクニカルサポートセンター

佐賀県伊万里市山代町楠久929番89

延床面積：998.21平方メートル

半導体機械修理作業・部品販売  
 現地静的精度検査・機械修正  
 操作再指導等のアフターサービス

開設日：2023年10月



株式会社プレシード

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺250-9

代表取締役社長 松本修一

各種自動化装置・各種省人化装置の開発、  
 設計、製作、販売

従業員数：110名

\* 写真は(株)プレシードHPより  
 © Okamoto Machine Tool Works, Ltd. All Rights Reserved.

# トピックス 九州半導体関連拠点展開②

2023年11月1日 大和工機株式会社を完全子会社化  
半導体産業の一大集積地となる九州で拠点展開を加速中

伊万里市

2023年10月より

「九州テクニカルサポートセンター」



大和工機株式会社

宮崎県都城市高城町穂満坊1002-2

産業機械・生産設備の製作・メンテナンス  
(半導体製造装置や真空装置などの組立・製造)

大型のクリーンルーム (洗浄度クラス10000)  
を複数棟所有

従業員数 53名

\* 写真は大和工機 (株) HPより

## 2. 2024年3月期 通期業績予想

# 2024年3月期の市場環境見通し

半導体、EV車関連とも中長期的な見通しは良好も、足元は景気減速の影響を受ける

半導体	<ul style="list-style-type: none"> <li>メモリ関係の在庫調整、需要回復の時期の見通しなどに不透明感。景気減速の影響を受け、一部設備投資計画の見直しな先送りが見られる</li> <li>次世代パワー半導体やEV車など車載向け半導体にかかる投資意欲は旺盛</li> <li>地政学的な要因もあり政策的挺入れから日米とも活発な投資を予想</li> </ul>
工作機械（国内）	<ul style="list-style-type: none"> <li>生産拠点の日本回帰の動きもあり工作機械需要は引き続き堅調を予想</li> <li>EV車関連向けの設備投資の活発化から大型平面研削盤などの需要増加を予想</li> <li>半導体関連でも引き続き堅調な需要を予想</li> </ul>
工作機械（海外）	<ul style="list-style-type: none"> <li>北米は高金利の持続が予想され、その影響あるも、EV車用バッテリーや半導体に関する投資計画の発表も多く今後期待</li> <li>欧州は地政学リスクあるもEV車、航空機などの堅調な需要を予想</li> <li>中国も一部減速あるもEV車、半導体関連などで引き続き堅調を予想</li> </ul>
精密部品・素材	<ul style="list-style-type: none"> <li>中長期的には省人化投資の加速からロボット需要増加、つれてロボット向けギア需要の増加を予想</li> <li>静粛性を求められるEV車など自動車向けも堅調</li> </ul>

# 通期業績予想

豊富な受注残などを梃子に中計最終年度の目標である売上高500億円、営業利益60億円の1年前倒しでの達成に全社を挙げ取り組む

(単位：百万円)

	2023年3月	2024年3月 (予想)	
	金額	金額	増減率
売上高	45,524	50,000	+9.8%
営業利益	5,598	6,000	+7.2%
経常利益	5,552	5,950	+7.2%
当期純利益	4,029	4,200	+4.2%

※小数点第2位を四捨五入

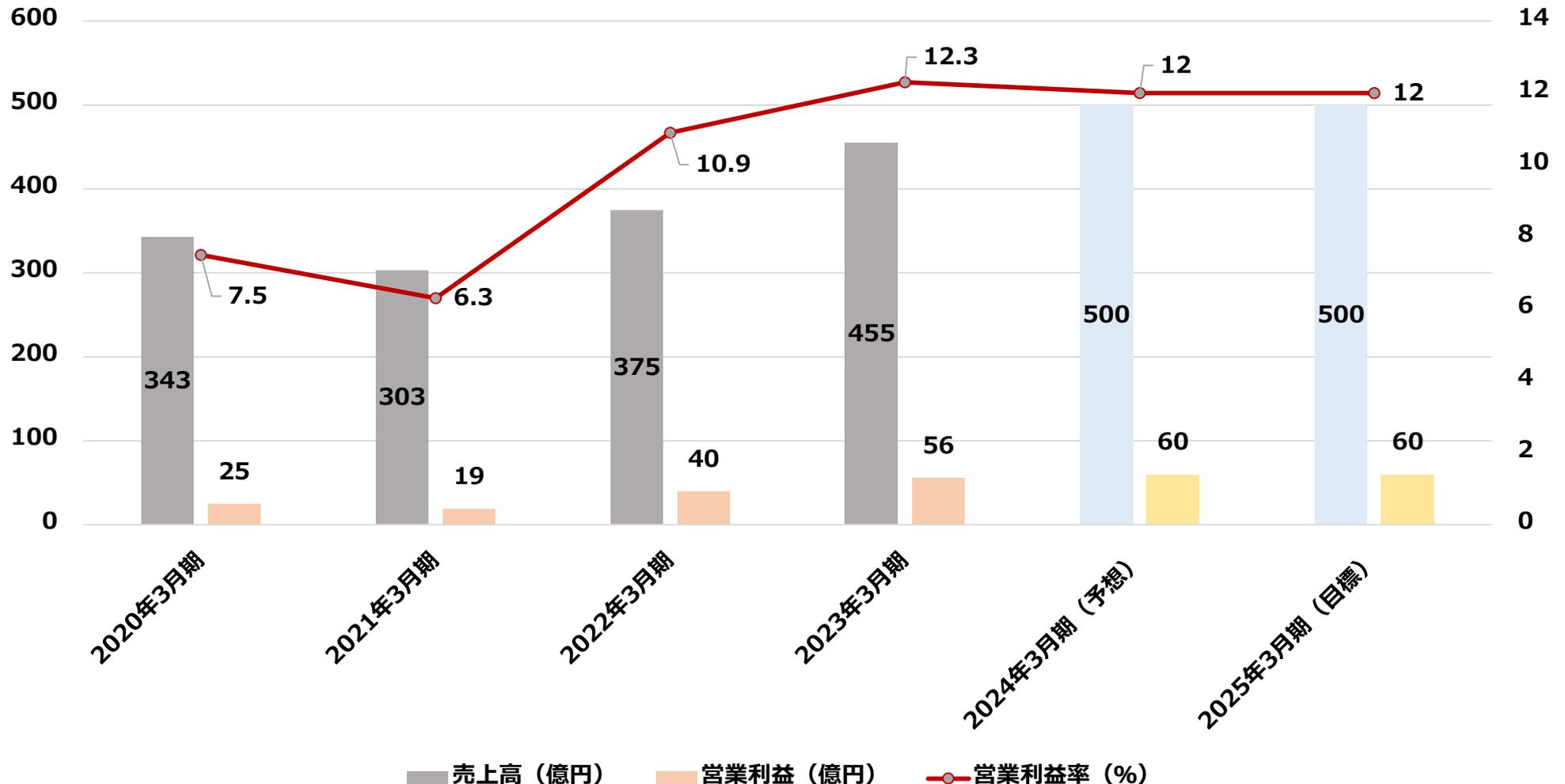
(単位：百万円)

	2023年3月	2024年3月 (予定)
	金額	金額
設備投資額	3,921	3,891
減価償却費	1,521	1,713
研究開発費	165	238
為替レート	2023年3月	2024年3月 (計画)
米ドル	136.00	130.00
シンガポールドル	99.05	98.00
ユーロ	141.62	139.00
タイバーツ	3.84	3.80
人民元	19.71	19.20

※期中の平均レートで記載しております

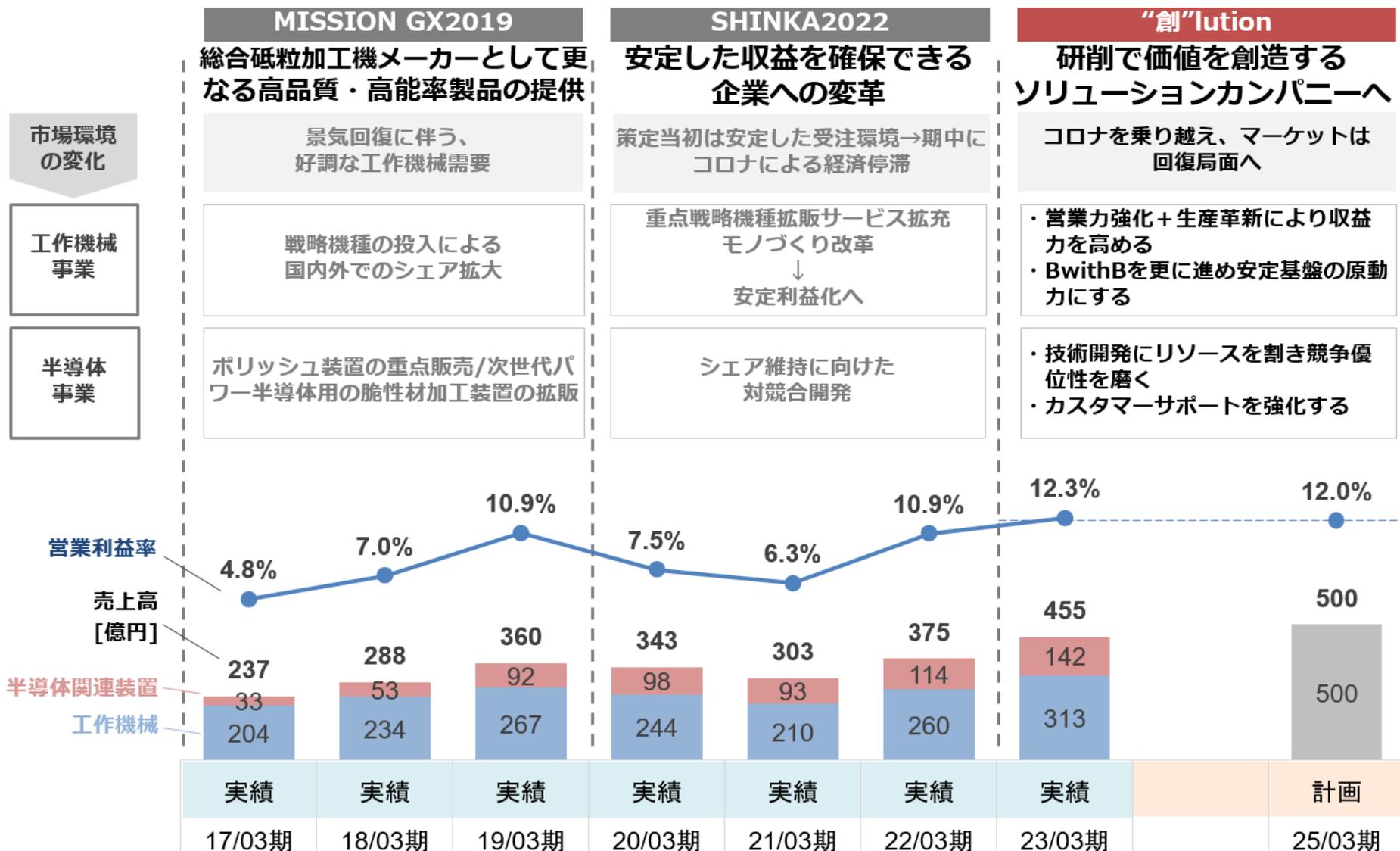
# 中計数値目標

中計最終年度、売上高500億円、営業利益60億円、営業利益率12%を目指す  
2024年3月、1年前倒しでの目標達成を目指す



# 3. 中長期戦略 「ビジョン2030」について

# 過去の事業展開と現中計の位置づけ



# 岡本グループ経営の基本方針

## 経営理念

常に最先端技術を追求し、お客様にご満足いただける精巧比なき、価値ある製品をつくり、社会に貢献する。

## 社是

技術は正しく

## 2030年に向けた中長期戦略の方向性

### 岡本グループの強み

高いグローバルシェアを誇る平面研削盤の事業基盤と、技術的強みを生かした半導体製造装置

### 半導体 製造装置

**【成長投資】** 工作機械で培った強みを生かした成長事業として位置づけ積極的な成長投資により、半導体市場の高度化・成長機会を捉え事業拡大

### 事業戦略

### 工作機械

**【成長投資】** コア機種 of グローバルシェア・収益力を更に引き上げるべく北米・中国・インド展開と国内サービス事業体制強化  
**【再構築】** 工作機種のラインナップ・生産体制、歯車事業等は採算重視の改革実施

### 財務戦略

持続的な企業活動のために、財務の安定性と成長事業への投資機会を確保しながら、株主還元の一層の強化を図る

# 2030年長期ビジョン・目標

## 2030年長期ビジョン・目標

### 長期ビジョン

世界に類のない「総合砥粒加工機メーカー」として、平面研削盤・半導体ウェハ研磨装置でグローバルNo. 1を目指す

### 財務目標

連結売上高：700億円

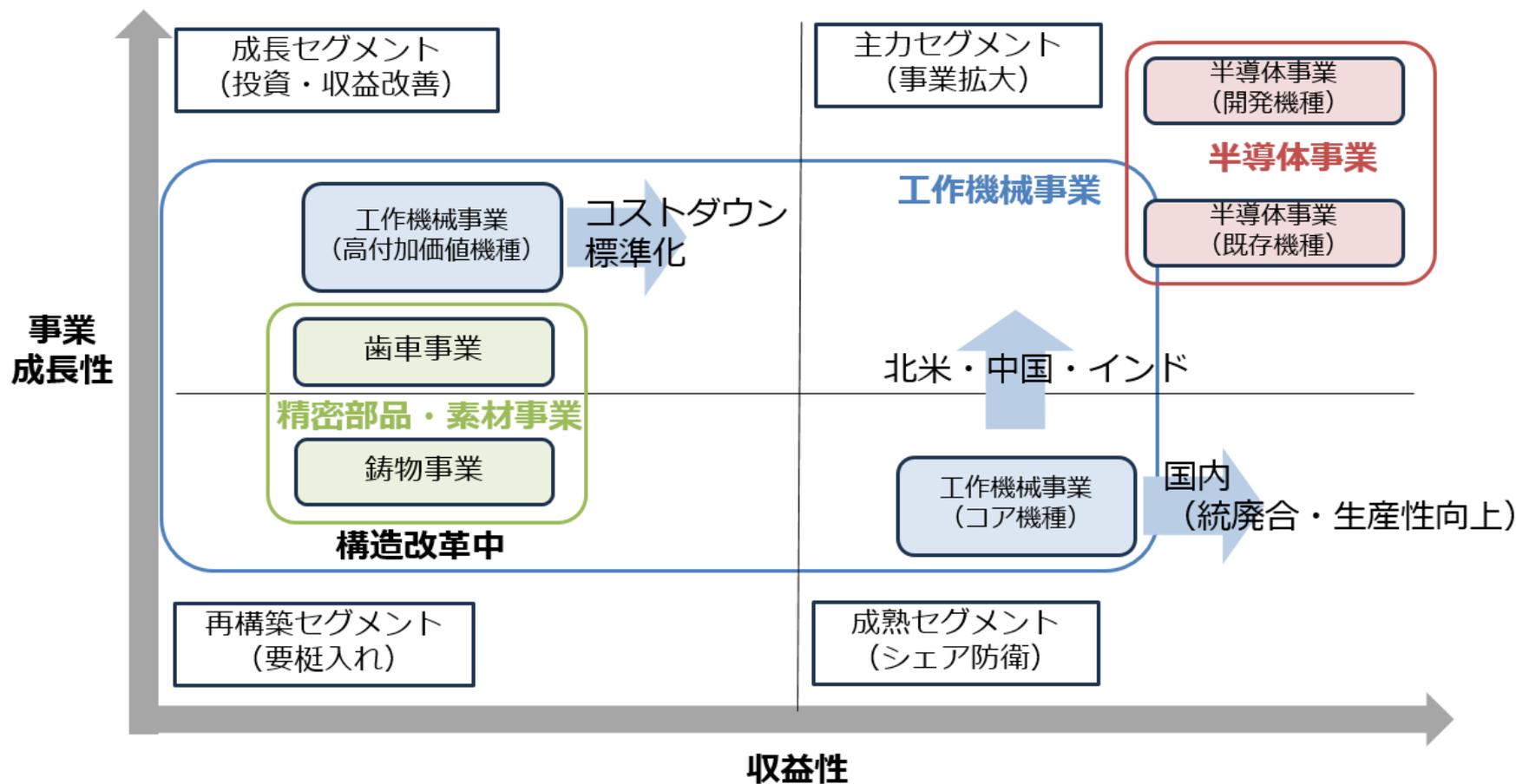
連結営業利益率：16%

ROE：17-18%

連結配当性向：30%以上

# 中長期戦略 事業ポートフォリオ

- 中長期戦略では半導体事業を主力セグメントとして位置付け、積極的な投資による事業拡大を図る
- 工作機械事業では、収益性の高いコア機種での成長を図るとともに、高付加価値機種へのテコ入れ、精密部品・素材事業の構造改革を進めていく



# 財務戦略 キャッシュアロケーション

2030年3月期は半導体事業を成長ドライバーとして売上700億円を目指す

		23/3期実績	24/3期計画	30/3期目標	
利益成長	全社売上高	455億円	500億円	<b>700億円</b>	
	工作機械	313億円	—	400億円	成長市場（中国・インド）での売上拡大 北米市場でのシェア拡大を図る
	半導体製造装置	142億円	—	300億円	半導体次世代開発を中心に成長投資を実行 パワー半導体（SiC/GaN）、及び通信デバイス （LT/LN）向けのグラインダ・ポリッシャの開発、 拡販による売上拡大を図る
	営業利益	56億円 (12.3%)	60億円 (12%)	115億円 (16%)	工作機械事業での収益力強化・収益性の高い半導体 事業の売上拡大
	ROE	17.80%	—	17%-18%	現在の水準以上を維持
キャッシュ アロケーション	EBITDA	71億円	—	135億円以上	
	営業CF	26億円	—	60億円程度	事業成長及び事業構成変化に最適な運転資本 (CCC) を追求
	投資CF	30億円	—	6ヶ年累計 180億円	成長投資、基盤投資に加え研究開発など主力セグメ ントである半導体事業を中心として投資を実行
	連結配当性向	21%	—	30%以上	株主還元を強化

# 半導体ロードマップ・戦略

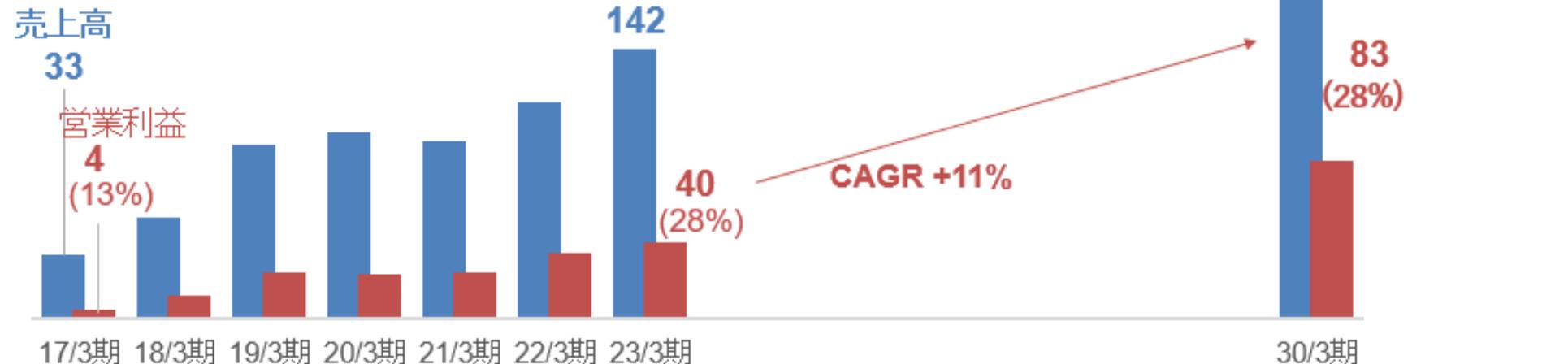
- 半導体事業での積極的な成長投資により、半導体市場の高度化・成長機会を捉え事業拡大
- 2030年以降の成長も見据えた開発・投資を実行

## 成長投資の実行

- ・次世代機種の新規開発  
(Siウェハ加工プロセス高度化対応、  
パワー半導体/通信デバイス向け  
ウェハ対応、TSV技術活用)
- ・デモ・ショールームの刷新

### ■売上増加額 内訳

- ・パワー半導体向け + 150億円 ~ 200億円
- ・通信デバイス向け + 10 億円 ~ 40億円
- ・シリコンウェハ向け シェア維持~拡大



※ 営業利益は、全社費用配分前

# 半導体事業 主力製品と競合他社に対する優位性①

- 当社の半導体事業は、半導体ウェハをスライスした後の平坦化工程にポジショニングしており、グローバルでの半導体ウェハ生産枚数は今後も増加することを想定



出所：(株)SUMCO 「2023年12月期第2四半期決算説明会」、QY ResearchおよびRSテクノロジー決算説明資料、エキスパートヒアリングにて当社調べ

# 半導体事業 主力製品と競合他社に対する優位性②

- 各マーケットに対して、既存製品の拡販だけでなく、競合優位性を生かした新製品も投下しながら成長を目指す

対象マーケット		当社主力製品	製品概要・優位性	事業展開方針
パワーデバイス	SiC	 ファイナルポリッシャPNXシリーズ	ウェハの薄型化を行うための グラインダ  高度仕様への対応力、 ポリッシャとグライ ンダの同時提案が 強み	高スループット かつ、より 低コストを実現 させるグラインダ 装置の開発に加 え、プロセス含め たトータルソ リユーション提案 により、 今後の市場拡大に 合わせて シェア拡大を図る
	GaN			
その他	LT/LN	 グラインダGNXシリーズ		

年平均成長率%  
(当社想定)

~  
+30%

~  
+30%

~  
+30%

出所：(株)SUMCO「2023年12月期第2四半期決算説明会」、QY ResearchおよびRSテクノロジー決算説明資料、エキスパートヒアリングにて当社調べ

# 開発テーマ

## 既存市場における高生産性機種種の展開と成長市場への新規開発機種種の投入

- 既存の12インチSiウェハ市場向けポリッシャにおけるシェアキープ&シェアアップ
- 成長の見込まれる次世代半導体市場向けのグラインダ、ポリッシャ製品の開発と投入
- 顧客との連携をより強化することで、市場要望を迅速に製品に反映

※次世代半導体材料として、SiCやGaN、LT/LN等を想定

既存市場	Si ウェハ向け ポリッシャ	ポリッシャにおける従来の実績を活かしシェアをキープするとともに、従来機に対し更なる生産性向上を実現する機械開発により競争力を維持
成長市場	次世代半導体 ウェハ向け グラインダ	高精度なグラインダ設備の開発と市場投入を行う。並行して生産性向上を実現するための機種開発にも取り組み競争力を獲得してゆく
	次世代半導体 ウェハ向け ポリッシャ	従来の大口径Siウェハ向けポリッシャのコア技術を活かし、大口径化が見込まれる次世代半導体ウェハ向けのポリッシャ開発と市場投入を行う
	次世代半導体 ウェハ向け バックグラインダ	実績を有する従来のコア技術をベースに、高剛性・高馬力を有するバックグラインダの開発と市場投入を行う

# ロードマップ実現に向けた強化方針

- 半導体事業ロードマップの実現に向けて、製造キャパシティの拡大やアフターサービスの充実等の準備を着実に進めている

外部パートナー企業と共に推進



## 成功の鍵

✓ 技術進歩の早い業界の中で、顧客方針を見極め応え続ける

✓ 高精度×安定稼働を両立する設計  
✓ 高い清浄度が要求される半導体装置の製造キャパシティ

✓ 顧客の複雑な製造工程にマッチするソリューションの提案/早期立ち上げ  
✓ 顧客の生産を止めないサポート体制

## 取組

- ・ 顧客と協働での次世代機開発・高度技術開発のより一層の推進（過年度より主要顧客と連携）
- ・ 開発・企画体制の強化（増員を計画中）

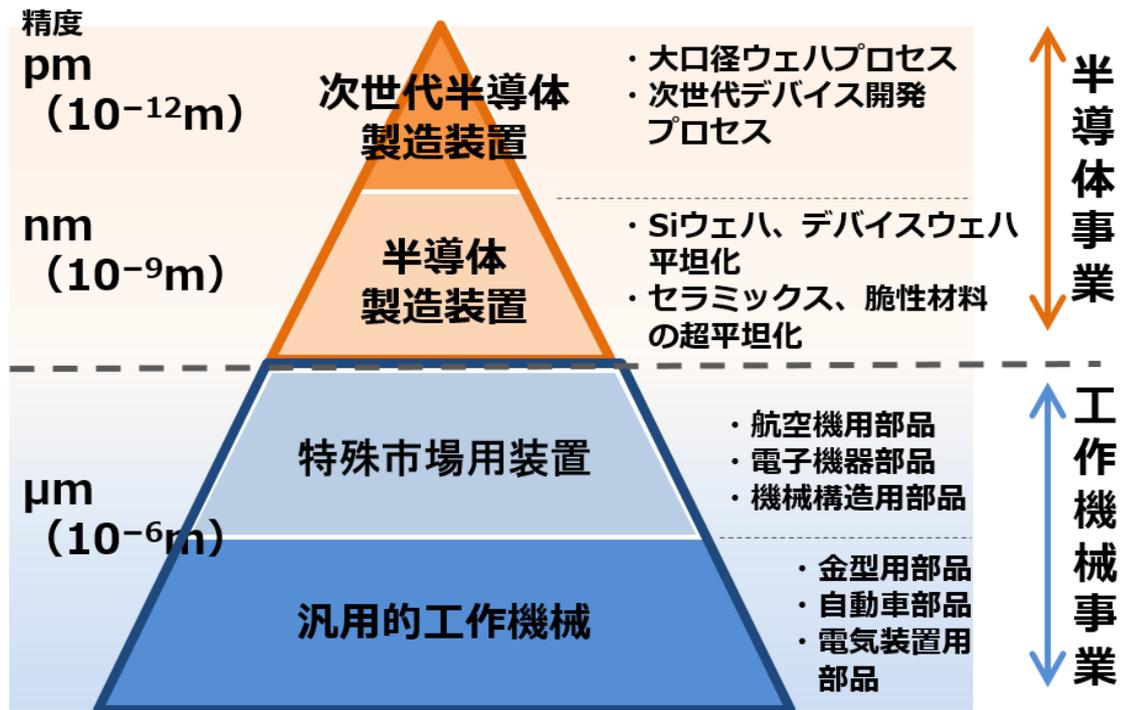
- ・ 工作機械事業の知見も生かした安定性の高い設計技術の更なる高度化・設計部隊の強化（資本参加した(株)プレシードとの連携）
- ・ 製造キャパシティの拡大/LT短縮（23年11月に完全子会社化した大和工機(株)のクリーンルームの活用、開発・生産システム刷新等）

- ・ プロセス最適化を含めたトータルソリューションの提供
- ・ グローバルアフターサービスの充実（中国拠点の人員強化およびサービスパーツ即納体制構築、九州テクニカルサポートセンター、23年4月に不動産取得、の活用等）

# 工作機械と半導体事業 シナジーについて

- 半導体事業は工作機械事業を土台として構築している事業であり、「工作機械としての高い安定性」×「半導体装置としての高精度」が、当社顧客から高く評価されている

✓コア技術である砥粒加工技術は同一であり相互に技術を蓄積



✓精度向上・精度安定のノウハウ  
※安定性に加え、高い精度要求ニーズにも対応可能

- ✓設計思想（高い安定性・信頼性）
- ※顧客ニーズの「高精度」と「高い安定性」の両立には工作機械の知見が不可欠

# Appendix

(ご参考資料)

## 会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	48億8051万円
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	【工作機械・半導体関連装置の製造・販売】 工作機械事業（平面研削盤・成形研削盤・内面研削盤・円筒研削盤・ 歯車研削盤・専用研削盤・精密歯車・鋳物） 半導体関連装置事業（グライディングマシン・スライディングマシン・ホーリングマシン・ラッピングマシン・ガラス基板研磨装置）
従業員数	連結: 2,225名 単体: 474名 ※2023年9月末現在



# 国内拠点、海外拠点



## 本資料に関するお問い合わせ先

**株式会社 岡本工作機械製作所**  
**総務部**  
**TEL 027(385)5800**

### 【本資料お取扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。